



2022年10月28日

各 位

会 社 名 丸 文 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 飯 野 亨
(コード番号 7537 東証プライム市場)
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 渋谷 敏 弘
電 話 番 号 03-3639-3010

2023年3月期 連結業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、最近の業績動向等を踏まえ、2022年5月13日に公表いたしました連結業績予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 連結業績予想の修正

(1) 2023年3月期 第2四半期連結業績予想の修正 (2022年4月1日～2022年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	91,000	1,600	1,300	750	28.70
今回修正予想(B)	101,000	5,200	1,100	450	17.22
増減額(B-A)	10,000	3,600	△ 200	△ 300	
増減率(%)	11.0%	225.0%	△ 15.4%	△ 40.0%	
(ご参考) 前期 第2四半期実績 (2022年3月期 第2四半期)	80,574	2,575	2,104	1,256	48.06

(2) 2023年3月期 通期連結業績予想の修正 (2022年4月1日～2023年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	195,000	5,100	4,500	2,900	110.96
今回修正予想(B)	220,000	10,500	5,000	2,950	112.88
増減額(B-A)	25,000	5,400	500	50	
増減率(%)	12.8%	105.9%	11.1%	1.7%	
(ご参考) 前期 実績 (2022年3月期)	167,794	5,994	4,106	2,437	93.26

(業績予想修正の理由)

2023年3月期 第2四半期連結累計期間の業績につきましては、民生機器向けや産業機器向けをはじめとした幅広い分野で半導体、電子部品の需要が想定を上回る水準で推移し、医用機器やレーザ

機器も堅調に推移したことにより、売上高および営業利益が当初予想を上回る見込みとなりました。一方、当会計期間中の急激な円安進行により、外貨建て借入の返済に伴う期中での決済差損や期末における外貨建て借入の評価損を営業外費用（為替差損）として計上する見込みとなったため、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は当初予想を下回る見通しとなりました。

2023年3月期 通期の業績につきましては、上期に引き続き民生機器向けや産業機器向け半導体およびレーザー機器の増加が見込まれることから、当初予想を上回る見通しとなりました。また利益面では、売上の増加や第2四半期累積会計期間中の円安進行に伴い円換算ベースでの売上総利益の押し上げが見込まれることから、上記の通り修正いたします。

(注) 上記の業績予想および配当予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。

以 上